

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣佈其為微影與蝕刻製程控管系列新增之兩款產品

*有助於 20nm 以下記憶體及微處理器晶片量產
所提供之先進的圖案技術的新型測量與檢測機台*

【加州 MILPITAS 2013 年 2 月 25 日訊】在國際光學工程學會 (SPIE) 先進微影會議上，KLA-Tencor 公司（納斯達克股票代碼：KLAC）宣佈，推出其 SpectraShape™ 9000 光學關鍵線寬 (CD) 測量系統和 BDR300™ 晶圓背面缺陷檢測與檢驗模組。SpectraShape9000 是一款新型測量系統，能夠監測三維電晶體、記憶體單元和其他關鍵結構的形狀，用於生產高性能的記憶體與微處理器晶片。BDR300 能夠檢測和檢驗晶圓背面的缺陷，這些缺陷會引起晶圓正面的結構圖案套製相關問題。這兩款新型系統的設計目標是要實現 20nm 以下積體電路的量產製造。

KLA-Tencor 行銷長 Brian Trafas 博士表示：「在這個高度擴展的 193nm 浸潤式微影時代，我們的客戶正在各個前瞻領域進行創新，以因應規格日益嚴格之微影及蝕刻製程控管。在這方面，我們今天推出的兩款產品能夠解決兩個關鍵製程控管問題：曝光掃描機的聚焦相關缺陷，以及鰭式場效應電晶體 (FinFET)、垂直堆疊的 NAND 和其他三維結構因形狀微小偏差而引起的故障或性能不良。BDR300 和 SpectraShape 9000 旨在協助我們的客戶從容應對他們現今在微影和蝕刻領域所面臨的巨大挑戰。」

新型 SpectraShape 9000 採用了雷射驅動的電漿光源，以及先進光學技術，使之能夠針對多種材料和結構均具備優異的尺寸測量能力。為了滿足業界對 20nm 以下更加嚴格的製程控管需求，亦即，在多層結構上更為密集的量測，SpectraShape 9000 比之前的產品具有更高的靈敏解析度和量測速度。它還支援專為多重圖像微影而設計的測量圖框。

CIRCL™ 集群系統中的新型 BDR300 晶圓背面檢測與複檢系統與其前一代相比，缺陷檢測靈敏度具有顯著改善，讓晶圓廠能夠發現晶圓背面的次微米級缺陷，這些缺陷，將影響先進製程的良率。CIRCL 集群系統現在可以供應為一套獨立的晶圓背面檢測與複檢系統，其組態設計可以支援不斷增長的生產製程需求，在晶圓進入曝光掃描機之前先對晶圓背面進行檢測。晶圓背面保持潔淨，能夠減少對曝光掃描機卡盤的污染及影響後續產品的良率。

邏輯電路與記憶體晶片的領先製造商已經安裝了多套 SpectraShape 9000 形狀測量系統，以取代現有的 CD/形狀測量工具，用以發展和提升新的技術，或者滿足對測量能力的更高要求

。包含 BDR300 模組的首套 CIRCL 集群系統也已安裝，用於主動監測曝光掃描機以及傳統的顯影後缺陷檢測。為了保持高性能和高產能，滿足最先進的生產需要，SpectraShape 和 CIRCL 系統由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務網路](#)提供支援。

關於 SpectraShape 9000 系統的更多資訊，請瀏覽 [SpectraShape 產品網頁](#)。關於 BDR300 模組或 CIRCL 系統的更多資訊，請瀏覽 [CIRCL 產品網頁](#)。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司是製程控管與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、發光二極體 (LED) 及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，超過三十五年一直為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com (KLAC-P)。

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 的預期效能，半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 的預期使用，SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 與 KLA-Tencor 其他工具的預期相容性，以及 SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 工具使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###